

# SMT Hybrid Packaging 2017

## 16. bis 18. Mai in Nürnberg

ZVEI-Forum am Mittwoch, 17. Mai 2017 10:00 bis 14:30 Uhr, Halle 5 Stand 221A:



Zeit	Thema / Abstract	Referent
10:00 – 11:00	Bauteilsauberkeit	Dr. Marc Nikolussi, Robert Bosch   Harald Hundt, Vacuumschmelze   Jürgen Frey Epcos TDK
11:00 – 12.30	Services in EMS Initiative: Ein System ist mehr als die Summe seiner Komponenten - Der EMS-Partner als Systemlieferant  Moderation:  1. Der EMS-Partner als Systemlieferant 2. Mechatronik Lösungen 3. Multifunktionsmodul Gebäudeautomation 4. Mehrwert	Dr. Peter Schmitt, CCS  Dr. Peter Schmitt, CCS Gustl Keller, Etroplan Jens Steinbeisser, Profectus Erwin Stöckinger, Zollner Elektronik
12:30 – 13:30	DesignChain in der Elektronikfertigung: „Was Industrie 4.0 nicht kann“ (Round Table)  Die Euphorie ist groß. Die Lücken in der angedachten Strategie sind es auch. CAD, Leiterplatte und Baugruppe werden den mutig formulierten Anforderungen nicht folgen können. Der AK Design des ZVEI informiert Sie in einem Round-Table-Gespräch über den realistischen Stand der Dinge.	- Harald Pasterk, CMS electronics - Dr. Peter Schmitt, CCS - Michael Sturm, Weidmüller - Arnold Wiemers, Ifa Feinleitertechnik - Markus Biener, Zollner Elektronik
13:30 – 14:30	Erfolgslösungen mit Keramik Basistechnik für elektronische Mikrosysteme  Einführung und Motivation Technologieübersicht Materialien und Applikationen  Diskussion und Schlussworte	Dirk Schönherr, Lust Hybrid-Technik Franz Bechtold, VIA electronic Stefan Flick, Heraeus Deutschland Walter Distler, Siegert electronic Dr. Peter Tauber, Robert Bosch  Dirk Schönherr, Lust Hybrid-Technik